

第32回 薄膜・表面物理基礎講座(2003年)

「最近注目されている薄膜電子材料の成膜法とその評価」

(<http://annex.jsap.or.jp/tfspd/>)

協賛 日本物理学会、日本化学会、日本金属学会、日本表面科学会、電子情報通信学会、電気学会、触媒学会、日本真空協会、電気化学会、表面技術協会、日本電子顕微鏡学会、高分子学会、精密工学会、日本結晶学会、日本結晶成長学会、日本応用磁気学会、日本セラミックス協会(依頼予定)

半導体デバイスの高性能化・高機能化を達成する技術開発が進められる一方、シリコンデバイスとは異なった機能・応用分野を持つ電子デバイスの開発や従来の半導体デバイスとの複合化による新しい機能の発現に注目が集まっている。これらの開発には、新しい薄膜材料の開発が不可欠であり、検討される薄膜材料の種類も急激に拡大している。それと共に成膜技術や評価技術も多様化している。本講座では、薄膜成長の基礎を理解すると共に、最近注目が集まっているカーボン系材料、有機材料、酸化物材料を取り上げ、その分野の第一線の研究者の方々によりそれぞれの薄膜材料に特徴的な成膜技術や特性評価について解説していただく。

日時:平成 15 年 10 月 30 日(木),31 日(金)

場所:東京工業大学 百年記念館 フェライト記念会議室

東京都目黒区大岡山 2-12-1 TEL:03-5734-3340 <http://www.rcd.titech.ac.jp/cent.htm>
東急大井町線、東急目黒線 大岡山駅より徒歩 1 分

プログラム:

日時	講演題目	講師
10月30日(木)		
総説		
10:45~12:00	薄膜成長の基礎	金原 稔(金沢工業大)
12:00~13:00	昼食	
カーボン系材料		
13:00~14:10	カーボンナノチューブ	中山 喜萬(大阪府立大学)
14:15~15:25	ダイヤモンド系薄膜の成長	藤森 直治(産総研)
15:25~15:40	休憩	
15:40~16:50	評価と応用	伊藤 利道(大阪大学)
10月31日(金)		
有機薄膜		
9:00~10:10	成膜法・気相法(MBE)	八瀬 清志(産総研)
10:15~11:25	成膜法・溶液法(LB)	藤平 正道(東京工業大学)
11:30~12:40	評価と応用	半那 純一(東京工業大学)
12:40~13:40	昼食	
酸化物薄膜(含む高・強誘電体薄膜)		
13:40~14:50	成膜法・気相法	奥山 雅則(大阪大学)
14:50~15:05	休憩	
15:05~16:15	成膜法・溶液法	加藤一実(産総研)
16:20~17:30	評価と応用	田畑 仁(大阪大学)

参加費:テキスト代、消費税含む

薄膜・表面物理分科会 会員*	応用物理学会会員・ 協賛学協会会員**	学生	その他
15,000円	20,000円	3,000円	25,000円

*薄膜・表面物理分科会賛助会社の方は、分科会会員扱いといたします。

**応用物理学会賛助会社の方は、応用物理学会会員扱いといたします。

定員:100名

*現在非会員の方でも参加申込時に薄・表分科会(年会費 A:3,000円,B:2,200円)にご入会いただければ、本セミナーより会員扱いとさせていただきます。下記URLより入会登録を行い、仮会員番号取得後、本セミナーに参加お申し込み下さい。紙版の入会申込書が必要な方は、下記事務局までお申し出下さい。入会決定後、年会費請求書をお送りいたします。セミナー参加費と同時に振込なさらないで下さい。

<http://www.jsap.or.jp/join/kojin.html>

申込方法:電子メール、FAX、はがきのいずれかにてお申し込みください。参加費は下記口座に参加者名でお振り込みください。入金確認後、参加証をお送りいたします。申し込み後の取り消し、不参加の場合にも参加費の払い戻しはいたしません。また、請求書の発行は原則としていたしません。領収書はセミナー当日にお渡しいたします。(申込要領:参加者氏名、住所、勤務先、参加費分類・振込額・振込予定日、会員No(仮会員番号)、電話番号、FAX番号、電子メール、参加証送付先(宛名用)(分科会賛助会社・応用物理学会賛助会社の方はその旨明記)

申込先:〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-12-3

井門九段北ビル5F

応用物理学会 分科会担当 伊丹

TEL:03-3238-1043, FAX:03-3221-6245

E-mail:divisions@jsap.or.jp

参加費振込先:三井住友銀行 本店営業部 普通預金 3132344

(社)応用物理学会 薄膜・表面物理分科会

申込締切:2003年10月17日(金)

問合せ先:東京工業大学大学院 総合理工学研究科 舟窪 浩

TEL:045-924-5446, FAX:045-924-5446

E-mail:funakubo@iem.titech.ac.jp

名古屋大学 先端技術共同研究センター

財満 鎮明

TEL:052-789-2762, FAX:052-789-5592

E-mail:zaima@alice.xtal.nagoya-u.ac.jp